

2019年9月4日

## テラダイン、高機能デジタル・デバイスの市場投入期間を最短化する UltraFLEXplus を発表

*革新的な PACE™ アーキテクチャがエンジニアリングの生産性向上、製品開発期間の短縮、生産コストの低減を実現します。*

*受賞歴のある IG-XL ソフトウェアを活用することにより出荷数 4,000 台を超える UltraFLEX との互換性を維持します。*

2019年9月4日、マサチューセッツ州ノース レディング発  
ATE(自動検査装置)のソリューションで業界をリードするテラダイン(Teradyne, Inc.、NYSE:TER)はUltraFLEXファミリーの最新メンバーであるUltraFLEXplusを発表しました。UltraFLEXplusは初めてPACEアーキテクチャを搭載し、AI(人工知能)や5G(第5世代移動通信システム)の出現によって変化する最新のデジタル・テスト要求に応えます。

デバイスの特性評価および量産時に扱うデータ量は現世代のテスター・アーキテクチャを凌駕しています。その結果、製品開発サイクルは拡大し、量産でのテスト時間は長くなる一方です。これら新規チャレンジに対応するためテラダインはPACEマルチ・コントローラ・アーキテクチャを開発し、UltraFLEXplusに搭載しました。PACEアーキテクチャはテストエンジニアによる複雑なデバイスのデバッグ、特性評価作業において従来に比べ遥かに効率を高める革新的な特許取得技術であり、エンジニアリング労力を削減し、テスター使用効率を高めることにより、新製品の迅速な市場投入を実現します。

UltraFLEXplusは革新的PACEアーキテクチャと業界をリードするIG-XLソフトウェアを融合することにより、半導体メーカーがこれら新しいテストチャレンジに対して成功裏に準備することを確実にします。テラダインのIG-XLソフトウェアは顧客に包括的な開発環境を提供します。また、最新のIG-XLを既存の4,000台を超えるUltraFLEXでそのまま使用することが可能です。これは約10,000人のIG-XLを学んだ現役のテストエンジニアがそのまま柔軟にテスト・プログラムを開発出来ることを意味します。

テラダインの半導体テストカンパニー社長のグレッグ・スミスは次のように述べています。“SOCデバイスにおいて2025年にはテストデータが2018年の8倍となると見積もられています。これはデバイスを包括的にテストする為に必要なデータ量、そしてテスト後にイーロード、性能の解析をする為に保持するテスト結果のデー

タ量の両者にあてはまります。このようなデバイスを短期間で市場投入し、業界をリードする低テストコストを実現するためには ATE(自動検査装置)のアーキテクチャに根本的な改良を加える必要があると認識しました。”

新 UltraFLEXplus テストシステムについての詳細は下記を参照、あるいはこちら [here](#) から TUGx セミナーに登録下さい。  
[teradyne.com/ultraflexplus](http://teradyne.com/ultraflexplus)

#### テラダインについて

テラダイン (NASDAQ:TER) はスマート・デバイス、救命医療装置、データ・ストレージ装置のような高品質で革新的な製品の短期間での市場投入を実現します。テラダインの半導体、電子機器、無線機器その他に関する先進的なソリューションはそれら製品が市場において設計通りに性能を発揮すること保証します。また、様々な規模の製造業で使用されている協働ロボット、自律移動ロボットをはじめとするテラダインの産業オートメーション向け製品は生産性向上と低コスト化に寄与しています。テラダインの 2018 年度の売上げは 21 億ドル (約 2,200 億円) であり、現在世界中で約 5,200 人の従業員を擁しています。詳しくは、[teradyne.com](http://teradyne.com) を参照下さい。Teradyne® は米国およびその他の国々における Teradyne, Inc. の登録商標です。

お問い合わせ先:

下記もしくは、各営業担当までお問い合わせください。

Kaleigh Sands  
Marketing Communications, Teradyne  
+1 (978) 370-6207  
[kaleigh.sands@teradyne.com](mailto:kaleigh.sands@teradyne.com)